

2026-2032年中国半导体设备市场竞争格局与投资机会研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2026-2032年中国半导体设备市场竞争格局与投资机会研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/E64775GMS4.html>

【报告价格】纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

【出版日期】2026-04-18

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明: 《2026-2032年中国半导体设备市场竞争格局与投资机会研究报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制,全面剖析了中国半导体设备市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议,规避市场风险,全面掌握行业动态。

第一章半导体设备行业基本概述第一节 半导体的定义和分类一、半导体的定义二、半导体的分类三、半导体的应用第二节 半导体设备行业概述一、行业概念界定二、行业主要分类第二章2021-2025年中国半导体设备行业发展环境PEST分析第一节 政策环境(POLITICAL)一、半导体设备政策汇总二、半导体制造利好政策三、集成电路企业税收优惠四、集成电路产业政策扶持五、产业投资基金的支持第二节 经济环境(ECONOMIC)一、宏观经济发展概况二、工业经济运行情况三、经济转型升级发展四、未来经济发展展望第三节 社会环境(SOCIAL)一、电子信息产业增速二、电子信息设备规模三、研发经费投入增长四、科技人才队伍壮大第四节 技术环境(TECHNOLOGICAL)一、企业研发投入二、技术迭代历程三、企业专利状况第三章2021-2025年半导体产业链发展状况第一节 半导体产业链分析一、半导体产业链结构二、半导体产业链流程三、半导体产业链转移第二节 2021-2025年全球半导体市场总体分析一、市场销售规模二、行业产品结构三、区域市场格局四、产业研发投入五、市场竞争状况六、企业支出状况七、产业趋势预测第三节 2021-2025年中国半导体市场运行状况一、产业发展历程二、产业销售规模三、市场规模现状四、产业区域分布五、市场机会分析第四节 2021-2025年中国IC设计行业发展分析一、行业发展历程二、市场发展规模三、企业发展状况四、产业地域分布五、专利申请情况六、资本市场表现七、行业面临挑战第五节 2021-2025年中国IC制造行业发展分析一、制造工艺分析二、晶圆加工技术三、市场发展规模四、企业排名状况五、行业发展措施第六节 2021-2025年中国IC封装测试行业发展分析一、封装基本介绍二、封装技术趋势三、芯片测试原理四、市场发展规模五、芯片测试分类六、企业排名状况七、技术发展趋势第四章2021-2025年半导体设备行业发展综合分析第一节 2021-2025年全球半导体设备市场发展形势一、市场销售规模二、市场结构分析三、市场区域格局四、重点厂商介绍五、厂商竞争格局第二节 2021-2025年中国半导体设备市场发展现状一、市场销售规模二、市场需求分析三、企业竞争力分析四、企业产品布局五、市场国产化率六、行业发展成就第三节 半导体产业核心设备——晶圆制造设备市场运行分析一、设备基本概述二、核心环节分析三、主要厂商介绍四、厂商竞争格局五、市场发展规模第四节 半导体产业核心设备——晶圆加工设备市场运行分析一、设备基本概述二、市场发展规模三、市场价值构成四、市场竞争格局第五节 半导体设备行业财务状况分析一、经营状况分析二、盈利

能力分析三、营运能力分析四、成长能力分析五、现金流量分析第五章2021-2025年半导体光刻设备市场发展分析第一节 半导体光刻环节基本概述一、光刻工艺重要性二、光刻工艺的原理三、光刻工艺的流程第二节 半导体光刻技术发展分析一、光刻技术原理二、光刻技术历程三、光学光刻技术四、EUV光刻技术五、X射线光刻技术六、纳米压印光刻技术第三节 2021-2025年光刻机市场发展综述一、光刻机工作原理二、光刻机发展历程三、光刻机产业链条四、光刻机市场规模五、光刻机竞争格局六、光刻机技术差距第四节 光刻设备核心产品——EUV光刻机市场状况一、EUV光刻机基本介绍二、典型企业经营状况三、EUV光刻机需求企业四、EUV光刻机研发分析第六章2021-2025年半导体刻蚀设备市场发展分析第一节 半导体刻蚀环节基本概述一、刻蚀工艺介绍二、刻蚀工艺分类三、刻蚀工艺参数第二节 干法刻蚀工艺发展优势分析一、干法刻蚀优点分析二、干法刻蚀应用分类三、干法刻蚀技术演进第三节 2021-2025年全球半导体刻蚀设备市场发展状况一、市场发展规模二、市场竞争格局三、设备研发支出第四节 2021-2025年中国半导体刻蚀设备市场发展状况一、市场发展规模二、企业发展现状三、市场需求状况四、市场空间测算五、市场发展机遇第七章2021-2025年半导体清洗设备市场发展分析第一节 半导体清洗环节基本概述一、清洗环节的重要性二、清洗工艺类型比较三、清洗设备技术原理四、清洗设备主要类型五、清洗设备主要部件第二节 2021-2025年半导体清洗设备市场发展状况一、市场发展规模二、市场竞争格局三、市场发展机遇四、市场发展趋势第三节 半导体清洗机领先企业布局状况一、迪恩士公司二、盛美半导体三、至纯科技公司四、国产化布局第八章2021-2025年半导体测试设备市场发展分析第一节 半导体测试环节基本概述一、测试流程介绍二、前道工艺检测三、中后道的测试第二节 2021-2025年半导体测试设备市场发展状况一、市场发展规模二、市场竞争格局三、细分市场结构四、设备制造厂商五、主要产品介绍第三节 半导体测试设备重点企业发展启示一、泰瑞达二、爱德万第四节 半导体测试核心设备发展分析一、测试机二、分选机三、探针台第九章2021-2025年半导体产业其他设备市场发展分析第一节 单晶炉设备一、设备基本概述二、市场发展现状三、企业竞争格局四、市场空间测算第二节 氧化/扩散设备一、设备基本概述二、市场发展现状三、企业竞争格局四、核心产品介绍第三节 薄膜沉积设备一、设备基本概述二、市场发展现状三、企业竞争格局四、市场前景展望第四节 化学机械抛光设备一、设备基本概述二、市场发展规模三、市场竞争格局四、主要企业分析第十章2021-2025年国外半导体设备重点企业经营状况第一节 应用材料 (APPLIED MATERIALS, INC.) 一、企业发展概况二、企业发展历程三、企业经营状况四、企业核心产品五、企业业务布局六、企业趋势预测第二节 泛林集团 (LAM RESEARCH CORP.) 一、企业发展概况二、企业经营状况三、企业核心产品四、企业趋势预测第三节 阿斯麦 (ASML HOLDING NV) 一、企业发展概况二、企业发展历程三、企业经营状况四、企业核心产品五、企业趋势预测第四节 东京电子 (TOKYO ELECTRON, TEL

) 一、企业发展概况二、企业经营状况三、企业核心产品四、企业趋势预测第十一章国内半导体设备重点企业经营状况分析第一节 浙江晶盛机电股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第二节 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第三节 中微半导体设备(上海)股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第四节 北方华创科技集团股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第五节 沈阳芯源微电子设备股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第六节 北京华峰测控技术股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第七节 拓荆科技股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第八节 盛美半导体设备(上海)股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第十二章半导体设备行业投资价值分析第一节 半导体设备企业并购市场发展状况一、企业并购历史回顾二、行业并购特征分析三、企业并购动机归因四、国内企业并购动态第二节 中国半导体设备市场投资机遇分析一、整体投资机遇分析二、建厂加速拉动需求三、产业政策扶持发展第三节 半导体设备行业投资机会点分析一、薄膜工艺设备二、刻蚀工艺设备三、光刻工艺设备四、清洗工艺设备第四节 半导体设备行业投资壁垒分析一、技术壁垒分析二、客户验证壁垒三、竞争壁垒分析四、资金壁垒分析第五节 半导体设备行业投资前景分析一、经营风险分析二、行业风险分析三、宏观环境风险四、知识产权风险五、人才资源风险六、技术研发风险第六节 半导体设备投资价值评估及建议一、投资价值综合评估二、行业投资特点分析三、行业投资前景研究建议第十三章中国行业标杆企业项目投资建设案例深度解析第一节 半导体湿法设备制造项目一、项目基本概述二、资金需求测算三、建设内容规划四、经济效益分析五、项目基本概述六、资金需求测算七、实施进度安排八、经济效益分析第二节 光刻机产业化项目一、项目基本概述二、资金需求测算三、建设内容规划四、经济效益分析第三节 半导体设备产业化基地建设项目一、项目基本概述二、资金需求测算三、项目进度安排四、项目投资价值第十四章2026-2032年中国半导体设备行业发展趋势及预测分析第一节 中国半导体产业投资预测一、技术发展利好二、自主创新发展三、产业地位提升四、市场应用前景第二节 中国半导体设备行业趋势预测展望一、政策支持发展二、行业发展机遇三、市场应用需求四、行业趋势预测第三节 2026-2032年中国半导体设备行业预测分析一、2026-2032年中国半导体设备行业影响因素分析二、2026-2032年中国大陆半导体设备市场规模预测图表目录图表1：半导体分类图表2：半导体应用领域图表3：半导体设备分类情况图表4：半导体

设备行业主要政策汇总图表5：半导体行业部分相关政策图表6：我国集成电路行业部分相关政策情况（一）图表7：我国集成电路行业部分相关政策情况（二）图表8：2020-2025年中国GDP发展运行情况图表9：2018-2025年中国全部工业增加值情况图表10：2020-2025年中国规模以上工业增加值增速情况图表11：2022-2025年中国规模以上电子信息制造业增加值同比增长统计图表12：2022-2025年中国规模以上电子信息制造业实现营业收入统计图表13：2021-2025年中国研究与试验发展（R&D）经费支出情况图表14：2020-2024年中国全年研究与试验发展（R&D）人员统计图表15：2022-2025年Q3部分重点半导体设备企业研发投入统计图表16：半导体设备技术迭代历程图表17：2017-2026年3月中国半导体设备行业相关专利申请趋势分析图表18：2017-2026年3月中国半导体设备行业相关专利申请人申请排名趋势分析图表19：集成电路产业链结构图表20：半导体产业链流程图表21：2015-2025年全球半导体行业市场规模情况图表22：2015-2025年全球半导体产品结构图表23：2015-2025年全球半导体区域市场规模图表24：半导体企业资本支出情况（单位：十亿美元）图表25：2015-2025年中国半导体行业收入结构图表26：2015-2025年中国半导体产业供需平衡统计图表27：2015-2025年中国半导体产业细分产品规模走势图表28：2015-2025年我国半导体产业市场规模走势图表29：国内半导体产业区域发展图表30：2026-2032年中国半导体行业市场规模预测图表31：集成电路IDM模式和Fabless模式的对比图表32：2017-2025年我国集成电路设计行业销售收入走势图图表33：2011-2025年我国集成电路设计企业数量走势图图表34：2011-2025年我国集成电路设计行业销售额过亿元企业数量走势图图表35：2024-2025年我国集成电路设计行业主要区域销售统计（单位：亿元）图表36：2013-2026年2月我国集成电路布图设计登记状况图表37：2017-2025年我国集成电路制造行业销售收入走势图图表38：晶圆代工厂在中国的主要布局图表39：集成器件制造商的晶圆制造厂在中国的主要布局图表40：半导体封装生产线工艺流程图表41：2017-2024年我国集成电路封测行业销售收入走势图图表42：我国集成电路封测行业领先企业图表43：2018-2025年全球半导体设备市场规模情况图表44：2018-2025年全球半导体设备行业产品结构图表45：2018-2025年全球半导体设备行业区域结构图表46：2018-2025年全球及中国半导体设备市场规模走势图图表47：全球各区域半导体设备企业特征图表48：2024/2025年全球主要半导体设备企业收入情况图表49：2018-2025年中国半导体设备行业销售规模情况图表50：2018-2025年中国半导体设备市场细分需求情况图表51：中国半导体设备重点企业区域分布图表52：国内半导体企业产品布局态势图表53：2018-2025年中国半导体设备国产化率水平图表54：半导体产业核心设备——晶圆制造设备分类图表55：晶圆制造核心设备示意图图表56：半导体制造工艺及对应设备图表57：国内主要晶圆制造设备企业介绍图表58：2024年中国主要晶圆生产企业收入情况图表59：2018-2025年中国晶圆生产设备市场规模情况图表60：芯片前道工艺的生产制备流程图表61：2018-2025年中国主要晶圆

加工设备规模情况更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/E64775GMS4.html>